

招商证券股份有限公司作为独立财务顾问

关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的 行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、 是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽 查且尚未结案情形等出具的书面意见

招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对通富微电本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：

一、核查内容

（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

经本独立财务顾问核查：

本次标的公司超威半导体技术（中国）有限公司（以下简称“AMD 苏州”）和 Advanced Micro Devices Export SDN.BHD（以下简称“AMD 槟城”）的主营业务为集成电路封装测试，可以满足从处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大 CPU 后期制造流程，使其同时具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），AMD 苏州和 AMD 槟城属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进

重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业中的“电子信息”行业。

（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

经本独立财务顾问核查：

通富微电的主营业务是集成电路的封装和测试，公司主要封装产品包括 SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM（MCP）、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC（Flip Chip）等系列产品，并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的 FT 测试及 PT 圆片测试服务。AMD 苏州和 AMD 槟城的主营业务是集成电路封装测试，可以满足从处理器半成品切割、组装、测试、打标、封装的五大 CPU 后期制造流程，使其同时具备对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试的能力。双方均属于中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，因此，本次交易属于同行业并购。

（三）本次重大资产重组是否构成借壳上市

经本独立财务顾问核查：

本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

（四）本次重大资产重组是否涉及发行股份

经本独立财务顾问核查：

本次交易为支付现金购买 AMD 苏州和 AMD 槟城的各 85% 股权。本次资产重组不涉及发行股份。

（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形

经本独立财务顾问核查：

上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（六）中国证监会或本所要求的其他事项

无。

二、独立财务顾问结论意见

本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323 号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：

1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12 部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业之一；

2、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；

3、本次资产重组不构成借壳上市；

4、本次资产重组不涉及发行股份；

5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司作为独立财务顾问关于本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等出具的书面意见》之签章页）

财务顾问主办人：

韩汾泉

何 淼

招商证券股份有限公司

2016 年 3 月 23 日